**烟台德邦科技股份有限公司**

**投资者关系活动记录表**

**证券简称：德邦科技 证券代码：688035 编号：2023-003**

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动**  **类别** | ■特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 ■其他(电话会议) |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 南方基金、淳厚基金、富国基金、中银基金、盘京投资、银叶投资、中邮电子、中信证券、泰康资产、华泰证券、国海证券、国信证券、太平养老、东方证券、长江养老、相聚资本、中信保诚、光大保德信、申万菱信、东北证券、鹏华基金、申万宏源、海通证券、彤源投资等 |
| **时间** | 2023年8月18日-2023年8月28日 |
| **地点** | 公司会议室 |
| **上市公司接待人员**  **姓名** | 公司副总裁、董事会秘书、财务总监：于杰  公司证券总监：战世能  公司证券事务代表：翟丞 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **1、公司各板块业务情况？**  答：2023年上半年从消费端看整体上处于弱复苏的态势，公司营业收入实现小幅增长。其中集成电路、智能终端板块得益于新的型号、新的应用点不断获得突破，二季度较一季度环比增长明显；新能源领域继续保持增长趋势，但增速放缓；高端装备领域得益于汽车轻量化等材料订单的增长，收入增幅相对高一些，综合下来上半年公司收入整体增幅为5.01%。  **2、公司集成电路领域产品有哪些新进展？**  答：公司集成电路封装材料，涵盖UV膜系列、固晶系列、导热系列、底部填充胶、AD胶（Lid框胶）等多品类产品，可以为客户提供最全面的封装解决方案，其中UV膜（含减薄膜、划片膜）产品、固晶胶、导热界面材料已在多家设计公司、封测公司批量出货。目前底部填充胶、AD胶、固晶胶膜（DAF/CDAF）、芯片级导热界面材料（TIM1）四款芯片级封装材料同时在配合多家设计公司、封测公司推进验证，其中AD胶、固晶胶膜（DAF）已陆续通过部分国内头部客户验证，获得小批量订单，实现零的突破；底部填充胶已通过部分客户验证，正在加快导入，导热界面材料（TIM1）部分型号已通过部分客户验证。  **3、公司底部填充胶、AD胶、固晶胶膜（DAF/CDAF）、芯片级导热界面材料（TIM1）四款芯片级封装材料具体应用领域有哪些？**  答：底部填充胶应用于芯片的倒装封装方式，只要是通过焊球实现芯片与芯片、芯片与载板链接的方式都会存在缝隙，而缝隙都要用底部填充胶进行填充，像CoWos、HBM、Fan-out等2.5D、3D封装方式对底部填充胶都是有需求的。  AD胶主要用于是Lid框跟载板之间连接的部位。所以只要存在Lid框，理论上就要用到AD胶。  TIM1应用非常广泛，大部分芯片的散热都是需要通过独立的散热器件实现散热，而芯片级导热材料是链接芯片和散热期间的媒介，尤其目前AI等高算力芯片发热大幅的增加，对芯片级导热材料的需求量将会大幅增大。  DAF/CDAF相关产品主要应用于芯片的多维封装、叠加封装等高端封装工艺，也可替代传统的固晶胶，且性能上、工艺上要大幅优于固晶胶，是公司在集成电路封装领域的重要战略布局。  **4、公司底部填充胶、AD胶、固晶胶膜（DAF/CDAF）、芯片级导热界面材料（TIM1）四款新的材料客户的采购情况、全年的收入预期？能否达到千万级的规模？**  答：公司芯片级底填、AD胶、TIM1、DAF/CDAF膜等这几个材料目前整体上还处于验证导入初期阶段，我们今年的主要目标是这几个产品能够通过较多客户的验证。AD胶、固晶膜（DAF）已经开始供货，但订单量还比较小，对我们来说的意义在于实现了从0到1的突破，几个系列产品今年的预期大概是大几百万的量，明年增量增长的机会比较多。  **5、这几个新的材料替代进口产品之后价格是否会有变化？毛利率大概在多少？**  答：产品在实现国产替代导入过程中，竞品一般会适当调低价格来应对，我们产品一般要保持比竞品低15~30%左右的价格优势。综合下来这几个新的材料毛利率有希望保持在50%以上。  **6、公司智能终端领域产品业务情况？今年或明年有没有新品或新的应用点导入？**  答：公司智能终端产品应用涵盖TWS耳机、手机、屏显、充电、AR/VR等多领域，其中TWS耳机已在国内外头部客户持续供货并获得了较高的市场份额，从去年下半年至今年上半年公司陆续在国外头部客户的Pad、充电、键盘等应用点上实现突破并开始小批量导入，未来几年将是逐步扩充应用点、上量的过程。同时公司持续跟进国外头部客户手机端的产品验证，期待明年会有所突破。  **7、公司集成电路、智能终端产品主要是替代进口，目前国内竞争格局如何？国产替代意愿如何？**  答：目前公司在集成电路领域主要的竞争对手是汉高、日立、日东、琳得科、信越、住友等国际品牌，国内少数几个公司在个别产品上与公司存在竞争关系，整体上国内品牌市占率很低，国产替代空间巨大。  公司材料在客户应用端价值量占比很小，但材料性能、稳定性对应用端产品又存在很大的影响，所以如无特殊因素客户的替代意愿并不强，但随着近几年市场环境的变化，国产化趋势的明显加剧，客户对材料端国产替代的诉求也明显提升，尤其在集成电路领域，近一段时间明显有更多的客户愿意寻求国产材料进行验证，我们将抓住有利时机，积极配合客户验证导入。  **8、公司新能源领域产品业务情况？**  答：1）新能源动力电池方面，公司已持续在众多动力电池头部企业批量供货，整体上占有较高的市场份额；  2）储能领域，公司已经实现行业主要客户宁德时代和阳光电源等的批量供货；  3）光伏领域，公司目前主要产品是叠瓦导电胶，比较稳定，在国内头部光伏组件厂商带动下，国内光伏组件产业链已经处于国际领先地位，在HJT、TOPCon等新兴光伏电池技术领域，公司基于0BB技术研发的焊带固定材料已于年初顺利导入国内某HJT客户，目前在持续快速上量，同时还有多家客户也在推进验证、导入。  **9、公司目前涉及四大应用领域，未来会不会考虑拓展新的业务领域？**  答：公司于2022年9月成功上市，上市是公司又一个新的起点，也会给公司带来新的机遇，公司会保证现有业务实现高质量增长，公司也会持续关注相关领域的发展机遇，未来也不排除在相关领域实现新的业务的扩充。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |